

機器利用技術講習会のご案内

【半導体デバイス製造用スパッタ装置】

地方独立法人大阪府立産業技術総合研究所では、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用頂くため、下記の要領で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

◆日 時：平成26年11月5日（水）10:15～14:00（昼食休憩の時間があります）

*当日、「触針式膜厚測定装置(14:15～15:30)」および「ホール効果測定装置(15:45～17:00)」の機器利用技術講習会も行っております。これらの講習会では、当講習会で作製した薄膜試料の触針式による膜厚測定と、同じ試料に対して電気特性評価のためのホール効果測定も行います。装置の理解をより深めるためにも「触針式膜厚測定装置」および「ホール効果測定装置」の機器利用技術講習会を当講習会とあわせて受講されることを強く推奨いたします。

◆場 所：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。

◆定 員：3名(1社1名まで)

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

※ 受講には TRI カードが必要です。まだお持ちでない方は、申し込み方法をご連絡いたします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課

※ お申し込みはメール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2509) までお願いします。なお、メールでお申し込みを頂いた方には、当研究所の関連情報をご案内する「産技研ダイレクトメールニュース」を配信させていただきますので、ご了承下さい。

○当研究所内に食堂がございます。一般のかたもご利用になれます。(営業時間：11:45～13:15)

◆対象機器：半導体デバイス製造用スパッタ装置

半導体デバイス製造用スパッタ装置は、マグネトロンスパッタ法を使用しています。マグネトロンスパッタ法は永久磁石から発生する磁場を利用して放電の電流密度を増加させるため、短時間で薄膜の作製ができます。作製可能な薄膜材料は金属、酸化物、窒化物等です。薄膜はセンサ、電子部品、太陽電池、LED、液晶、有機 EL 等の電気配線、絶縁膜、表面保護膜、機能性膜等、種々の用途に利用されています。真空中で3層の異種材料の積層膜の作製が可能です。

本講習会は、初めてスパッタリングによる薄膜作製を行う方を対象に、機器の概要説明を行なった後、装置の操作方法を説明し、薄膜作製の実演を行います。



機器型番：CR-SP-3NN
株式会社クライオバック

◆講習担当：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所

制御・電子材料科 佐藤 和郎、山田 義春、田中 恒久

・お問い合わせ先：顧客サービス課 (TEL：0725-51-2518)

